

マイクロシステム融合研究開発拠点

実施予定期間：平成19年度～平成28年度

総括責任者：井上 明久（東北大学総長）

協働機関：(株)リコー、(株)トッパン・テクニカル・デザインセンター、(株)メムス・コア、(株)北川鉄工所、住友精密工業(株)、トヨタ自動車(株)、日本信号(株)、日本電産コパル電子(株)、日本電波工業(株)、バイオニア(株)、メムザス(株)豊田中央研究所(株)、ニッコー(株)、日本航空電子工業(株)

I. 概要

20世紀後半のLSI技術の驚異的發展によって、以前には想像できなかった情報化社会が訪れている。今後、LSIが支える情報通信技術のさらなる発展と徹底的普及とによって知的生産性が向上し、そのインパクトは、産業革命が物質的生産性に与えたのと並ぶものになると考えられる。また、生活の視点からは、高齢化が進み環境問題への対応が求められ、あらゆる空間で、安全・安心・健康を実現できる社会システムが求められる。また世界的潮流として、IMECやオルパニーなどの例に見るように欧米では複数の企業が結集して拠点を作り、知を結集させて「特異な技術」を克服し強い国際競争力を生み出すとの動きが加速している。

我が国の将来を考えると、情報通信技術の発展・普及と社会システムの改革とを両輪として、知的生産性向上と働き方の多様化とを同時に進め、強い国際的産業競争力に裏打ちされた社会を持続的かつ健全に発展させる戦略が重要である。そのため、情報技術の基盤であるLSI技術をさらに発展させていく必要があるが、一方で、LSI開発は従来のように単独企業で取り組める規模を超えており、開発スピードや投資などの問題もあって日本企業の撤退が進んでいる。

このような状況で、最先端LSI技術とMEMS (micro electro mechanical systems) 技術とを融合し、限界が近付いているLSIの微細化追及からのパラダイムシフトを起こし、安全・安心・健康を実現できる社会システムを支える高度なマイクロシステムを、欧米に負けないスピードと資本、および総合的な研究開発力で実現していく必要がある。そのためには、技術の融合という技術的視点とともに複数の企業や大学の知の結集を可能とする「場」とそれを支える知財や人材、研究開発から産業化へのしくみといったシステム改革の視点も同時に構築せねばならない。

1. 機関の現状

幸いにも本学には半導体研究の輝かしい歴史と蓄積とがある。その半導体微細加工に多様な技術を組み合わせ高付加価値のシステムデバイスを作るMEMS技術に関する研究開発を35年程前から精力的に推進してきた。共用施設を学内外の約400名の研究者で利用して大きな研究成果をあげており、本分野で世界的にトップレベルにあることは内外の広く認めるところである。開発した技術を世の中に発信するだけでなく、大学の共用施設を活用し、企業との共同研究や技術移転を積極的にを行い、産業支援や製品化に貢献してきた。日本経済産業新聞の調査では、研究総括の江刺正喜教授が率いる研究室が「我が国で最も産業界に貢献している」との評価を得ている。この他、仙台市、宮城県、および東北大学を中心に

して「MEMSパークコンソーシアム」を2004年10月に設立し、これに100社以上が参加して、MEMSを中心とする産業振興や人材育成を行っている。

2. 拠点化の対象とする先端融合領域及び研究開発

a. 概要

このような土壌の上に、大学の知が触媒となって様々な技術、企業、研究者が開かれた研究開発システムのもと結集し、集積化マイクロシステムを中核に、機械、電気・電子、材料、化学、電気化学、バイオ工学、医学などの様々な技術を融合させて、我が国の次世代産業の種を創る知的活力源となる研究開発拠点を形成する。そうすることで、様々な機能を担うマイクロシステムが、情報処理・記憶機能を担うLSIと融合し、安全・安心・健康を支える社会的なイノベーションをもたらす。また、システム改革の視点からは、次世代産業の種を早期にイノベーションに繋げるため、多領域にわたる企業や研究機関が、産学・産産学連携を行って総合的な知の結集で、研究段階から事業へと結びつけることができる開かれた「場」を構築する。そのためには、参加各企業が安心して連携できる研究開発のシステムや新規な知財ルールの構築、人材育成にも取り組んでいく。そうすることで、研究から事業化への間に横たわる障害を克服しスピードを持って事業化への道筋を提供できる「場」とすることができ、強い産業競争力を生み出せる。

b. LSI技術とマイクロシステム技術との融合

ムーアの法則に沿ったLSIの発展、すなわち微細化の追求には明らかに物理的経済的限界が見えつつある。そこからのパラダイムシフトの有望な方法が、LSI技術とその他の技術との融合 (More than Moore と呼ばれる) であり、その中でも最もイノベーションが期待されるものがMEMSを中心とするマイクロシステム技術との融合である。これは長期的ビジョンを持って進むべきマイクロシステム分野のメインストリームである。

LSIとマイクロシステムとをチップ内で集積化する方法として、次の3つの方法がある：1) LSI形成後LSIに損傷を与えない低温工程でLSI上にマイクロシステムを形成 (LSI first)、2) シリコンウエハ内部にLSI製造の高温工程に耐えられるマイクロシステムを形成した後、その表面にLSIを形成 (MEMS first)、3) LSIとマイクロシステムとを別々のウエハ上に形成し、ウエハレベルで両者を結合 (Wafer-level integration)。最先端デザインルールのLSIと最先端MEMSの双方に損傷を与えないで最高のパフォーマンスを実現するには、装置開発やプロセス設計、さらには低温接合、実装、マイクロシステムとLSIの統合設計など多くの基盤技術の研究開発が必要である。これらの技術が基盤となり、様々なLSI集積化マイクロシステムが実現されていく。東北大学では、最初の3年間でこれらの技術のための装置・設備を整備し、デバイスの研究開発と並行して基盤技術を構築する。

c. 分野融合のための開かれた研究開発の「場」の形成

我が国では、高価な装置が研究室毎に設置されるので、全体の研究開発投資という意味でも無駄がある。また、自らの研究室内の装置だけでできる研究が行いがちであり、総合的で実際的な研究開発は行えない。東北大学には施設・装置共用の実績があり、これを基に自立的な運営体制を可能にするスキームを構築する。ここで共通性の高い基盤技術の研究開発を継続して行い、それを求心力に多くの応用展開企業が産

学、産産学連携のもと次世代産業創出の場を作る。

実際の研究開発方式として「乗合ウェハシステム」を採用する。マスクセットだけで数千万円以上する最先端 LSI を 1 つの研究プロジェクトで試作することは難しい。まして、研究開発レベルのシステムのために高価な LSI をリスクを負って試作してくれるファンドリーはなく、融合化マイクロシステムの実証は実質的に不可能となっている。したがって、複数の研究プロジェクトが同じウェハに相乗りする。そうすることで、産業化へのリスク低減が図れ、試作も受け入れてもらい易くなり、研究から産業化までに存在する「死の谷」等の克服を早期に図ることができる。同時に、拠点で生まれた基盤技術が参加企業間で利用できる仕組みや、乗合ウェハシステムで同居した企業間での秘密保持などの法的な保護もはかれる知財や秘密保持の仕組みも構築していく。

3. 拠点化構想の内容

a. 運営システム改革の内容

東北大学は、総長のリーダーシップの下、部局をまたぐ分野融合型研究活動を支援する「特定領域研究推進支援センター」を 2006 年 4 月に設立し、本センターの下に専属の事務局を立ち上げ、予算管理・執行、人事管理、対外活動などの総合支援体制を整備してきた。

産学連携に関わる知的財産の取り扱いについても新しい制度を協働機関代表者と本学教員からなる運営委員会で、本学知的財産部の参画を得て作成している。生み出された基盤技術の知財については協働機関の利用を担保する「パテントバスケット方式」で運用する。企業との共同発明に対しても本方式は適用され、知財面から開かれた「場」を担保する。また、これにともなう法的な取り決めによって、「場」における産産間の共同研究開発を保護する。

また、MEMS-LSI 融合のための企業からの研究者の採用、協働機関と共同での MEMS 設計実習や教育プログラムの作成や実施など、多様な人材の育成と活用を図る。また、MEMS 分野についての外部に対する定期的集中講義の実施、協働機関から大学への派遣研究者の on-job トレーニングなどによる人材育成を図っていく。

b. 企業との協働体制

マイクロシステム技術と LSI 技術を中核に、様々な技術を融合し、技術社会システム分野とも連携しながら、次の 6 つのグループで研究開発を実施する。また各グループと協働機関は毎月融合推進研究会に参加して情報と研究開発成果を共有し、研究の方向性を議論して技術融合を促進する。更に、協働機関は運営会議、スタッフ会議で拠点運営に参加する。拠点内人材育成にも従事する。

1) 次世代携帯機器

協働機関：(株) トッパン・テクニカル・デザインセンター、日本電波工業 (株)、

2) 無線センサ、超高感度・高機能センサ (桑野、小野、田中、長澤、三浦)

協働機関：住友精密工業 (株)、日本電産コパル電子 (株)、(株) 北川鉄工所、パイオニア(株)、(株)トッパンテクニカルセンター

3) 光マイクロシステム

協働機関：(株) リコー、日本信号 (株)、トヨタ自動車 (株)、(株) 豊田中央研究所

4) バイオ・医療マイクロシステム協働機関：ムザス (株)、日本航空電子工業 (株)、(株)トッパンテクニカルセンター

5) 製造・検査装置

協働機関：(株) メムス・コア、(株) リコー、トヨタ自動車 (株)、(株) 豊田中央研究所、ニッコー (株)

6) 技術社会システム

4. 具体的な達成目標

a. 3 年目における具体的な目標

3 年目までに、マイクロシステムと LSI とを一体化した新しい集積化マイクロシステムを実現するための基盤技術を立ち上げる。

ウェハ上で両者を集積化するための基盤技術、具体的には、低温形成技術、応力制御技術、複数の要素の貼り合わせ技術、立体的な配線形成技術などを開発する。また、LSI 上に様々なマイクロシステムを作る乗り合いウェハ方式を試みる。様々な応用に向け、具体的なマイクロシステムの研究開発を行い、課題のフィージビリティスタディを完了する。本拠点に最適な研究開発システム構築のため、海外拠点の研究開発システムを調査・研究する。

(1) LSI とマイクロシステム機能一体化 (融合) の技術確立のため、デザインルール 0.35 ミクロン以下の LSI を対象とし、LSI First、MEMS First、Wafer-Level Integration のためのプロセス、装置、実装の各技術の研究を実施し、実用化に向け研究課題を明確化する。LSI ウェハと、MEMS 工程用 SOI ウェハの貼り付けからなる一連のプロセスは、最重要基盤技術としてプロセスの原型を確立する。

(2) 複数のマイクロシステム機能を融合するため、要素となる個別分野デバイスの研究を実施する。MEMS 機能デバイスと、一体化すべき LSI を乗り合いウェハ上に試作評価し、システム実現の方法としての妥当性を検証する。これにより実用化に向け研究課題の明確化を図る。

(3) 拠点を担う人材を育成するため、拠点に参加する研究者、学生に対する導入教育プログラム、専門教育プログラムを構築する。また、一般社会人向けの実践的育成プログラムを実施し、不足しているマイクロシステム分野の研究開発者を育成する。

b. 7 年目における具体的な目標

最先端デザインルールの LSI とマイクロシステムを一体化するプロセス、装置、実装の各技術の研究開発課題を解決し融合化の基盤技術を確立する。開かれた研究開発拠点としての共用施設を整備し研究開発システムを構築する。また、継続的に行っている各分野のマイクロシステム研究開発と並行して、これらに幅広く適用できる LSI を開発する。さらに、具体的にいくつかの融合化マイクロシステムの機能を確認し実用化の見通しを得る。また、拠点を支えるスタッフの育成や産業界の状況を理解し共同研究を的確にマネージメントできる人材を育成する。

c. 実施期間終了後における具体的な目標

開かれた研究開発拠点として、さまざまな企業、研究機関、行政機関と連携しながら継続的に新たな技術開発を先導し、将来応用のためのマイクロシステムの研究・開発を通じて、関連産業の国際競争力向上に寄与する。

終了時には、開発した融合化の技術が様々な分野で市場競争力のある製品の実用化に供される。それらをもとにしたシステム化により、知的生産性を向上させるための創造空間や、将来の人・車・社会を考えた安全で快適な移動空間など、社会の安心、安全、健康等を実現する新規産業形成を担う。これらは、「パテントバスケット」の知財群および「乗り合いウェハシステム」に基づく開かれた研究開発システムからなる本拠点により支えられる。また、専門的知識を有すると共に拠点を理解する人材を育成し、本拠点がマイクロシステム産業のイノベーションを支える人材の供給源となる。

5. 実施期間終了後の取組

複数の企業や研究機関が共同で研究開発できる施設面、知財面、また研究開発システムである「乗合ウェハシステム」などに裏打ちされた「場」としての開かれた研究開発拠点で、

産産学連携を、大学の知を触媒として継続して実施していく。そうすることで世界的に競争力のある融合化マイクロシステムとその応用製品の研究開発が、設計、要素研究から試作、実用化まで早期に一環して行える拠点が実現する。

さらに教育・人材育成プログラム、国際連携などによって、最高の技術、人材、情報、および機会（テーマ）を最適な時間とコストで社会に提供する場を、民間資金に地方や国の投資を加えて、自立的に維持する。そうすることで、知と産業技術の世界的集積拠点へと発展させていく。

6. 期待される波及効果

本構想で整備する共用施設、知財の仕組み、複数の企業が研究レベルで参加できる「乗り合いウエハシステム」は、他の研究機関や企業にとっても魅力であり、国内外を問わず幅広い参加が見込まれる。本拠点は大学の知を触媒とした企業間や研究機関間の垣根を取り払ったわが国初の産学、産産学連携に基づく開かれた研究開発システムとして、技術面、社会システム面からも野心的拠点となっている。協力関係にあるフラウンホーファ研究所などの先進的海外研究機関の参加

も期待できることから、日本の研究および産業の一層のグローバル化、国際競争力向上を引き起こすことができる。そのため、研究開発プロセス、社会システムの両面から他研究機関のシステム改革の先駆けとなる。

7. 実施体制

東北大学総長のイニシアチブのもと、特定領域研究推進支援センター、本拠点参加全教員、全協働機関の代表者からなる運営委員会を最終意思決定機関とする。さらに、教員代表者および主要企業の代表者からなるスタッフ会議を設け、協働機関の日常的拠点運営への参加を図り、迅速な運営上の意思決定や課題解決を図る。運営委員会やスタッフ会議の下に必要なに応じて具体的な課題（施設運営、知的財産、広報、研究開発システム）を担当するワーキンググループを設け、現場に即した機動的な意思決定を可能とする。また、融合推進研究会を設置し、拠点全参加教員、全協働機関で実施されている研究や進行状況の発表、討論を実施する。そうすることで、拠点内の研究の共有化や参加教員、協働機関の融合も図れる

拠点化構想に関わる研究者等

氏名	所属部局・職名	当該構想における役割
◎井上 明久	東北大学 総長	総括責任者
○江刺 正喜	東北大学 教授	研究統括、
田中 秀治	東北大学 准教授	次世代携帯機器の研究リーダー
小野 崇人	東北大学 教授	無線センサ、超高感度・高機能センサの研究リーダー
羽根 一博	東北大学 教授	光マイクロシステムの研究リーダー
末永 智一	東北大学 教授	バイオ・医療マイクロシステムの研究リーダー
寒川 誠二	東北大学 教授	製造・検査装置の研究リーダー
原山 優子	東北大学 教授	技術社会システムの研究リーダー

8. 各年度の計画と実績

a. 平成 19 年度

計画； LSI と MEMS の融合（集積化）の基盤技術開発の一環として、乗り合いウェハを設計する。また、融合化のための接合・貼り合わせ、低ダメージプロセス、実装評価などの基盤技術の開発を開始し、個別マイクロシステムの設計・試作などを行う。また、知財を含む成果物の取り扱いに関する最適な契約基盤の検討を進める。

・実績

(1) 次世代携帯機器の研究

デバイスや不要電磁放射を抑制する技術、材料に関する研究開発を行い、デバイス設計や試作まで進め成果を得た。乗合ウェハシステムを立ち上げ LSI の設計を進めた。

(2) 無線センサ、超高感度・高機能センサの研究

表面弾性波や電磁カップリングを利用した各種センサ、過酷環境向けセンサを開発した。アセンブリ技術も開発し、デバイスを試作し動作を確認した。さらに乗合ウェハの CMOS LSI 設計を開始した。

(3) 光マイクロシステムの研究

接合技術について研究し、可塑性ポリイミドや低融点金属を用いた低温精密な接合技術も開発した。大きな変位量や、回転角が温度に無依存のマイクロスキャナも開発した。

(4) バイオ・医療マイクロシステムの研究

細胞の遺伝子発現を電気化学的に計測するチップを作製し細胞を局所領域に固定することに成功した。超音波内視鏡のための集積回路の設計を行うとともに、その集積化実装技術についても研究を行った。

(5) 製造・検査装置の研究

基盤技術となる LSI と MEMS の融合化技術確立を行っている。①高精度ウェハー張り合わせ技術の発案と検証準備②MEMS と LSI 用新しい低損傷エッチングプロセスの原理確認③新しい電子線リソグラフィ用並列アレイ電子源の電子放出確認④MEMS/LSI 実装信頼性技術の bumps 接合の高速・高精度評価方法の開発⑤プラスチックパッケージ用コンフォーマル製膜技術開発用装置試作。⑥MEMS/LSI デバイスの微小高周波磁気信号評価の原理確認

(6) 技術社会システムの研究

知財を含む成果物の取扱いの検討を行い、大学、企業が基盤技術の知財を共有する「パテントバスケット」の導入を図った。また、マイクロシステムの研究開発を行っている海外拠点を調査し、拠点形成のための問題点の抽出を行った。

b. 平成 20 年度

・計画； 様々の LSI が試作された乗り合いウェハ上に、各研究チームがマイクロシステムを形成する。試作システムを評価し新たな研究課題を把握して、次回の乗り合いウェハの設計にフィードバックする。これらの研究開発を通じて、貼り合わせ、低温プロセス、低欠陥成膜・エッチング、実装などの基盤技術を明確化していく。協働機関との新たな知的財産システム（パテントバスケット）を充実させて運用する。また、乗合ウェハシステムのルール化を実施していく。

・実績

(1) 次世代携帯機器の研究

無線フロントエンド回路部品、高密度記録デバイス、エネルギー源、不要電磁放射抑制技術について研究した。原理実証、材料開発からデバイス試作までのフェ

ーズを並行的に進めた。「乗合いウェハシステム」により、LSI 設計し、LSI 上での MEMS プロセスの開発をした、デバイスの試作を行い原理を実証した。

(2) 無線センサ、超高感度・高機能センサの研究

無線センサ、超高感度振動型センサ、および過酷環境向けセンサの開発を進めた。これらマイクロシステムに LSI を集積化するため CMOS 回路の設計を進め、試作した LSI との融合技術を開発した。

(3) 光マイクロシステムの研究

レーザーレーダや周囲環境認識センサシステム用光マイクロデバイスの研究を行った。走査領域可変や低電圧駆動を狙った光スキャナの試作・駆動に成功した。解像度可変用焦点可変ミラーを製作し、光スキャナと組み合わせることに成功した。また微小光学部品用に、金属間化合物やポリイミドを用いた接合技術を開発した。GaN 発光ダイオード構造を Si 基板上に形成する方法を開発した。

(4) バイオ・医療マイクロシステムの研究

マイクロアレイ電極デバイスを作製し、遺伝子発現活性を単一細胞レベルで電気化学的に網羅的に検出することに成功した。電気化学バイオリソグラフィ法を用いて、流路に実装の集積型水晶振動子センサで抗体の固定、抗原-抗体反応を計測できることを示した。また、血管内イメージャ用の小型超音波トランスデューサ用 LSI、体内で核磁気共鳴信号を受信し軟部組織を高解像度イメージングするプローブ搭載用 LSI の設計を行った。

(5) 製造・検査装置の研究

以下の研究開発を進め、原理実証や機能確認を実現した。①並列電子線描画システム、②コンフォーマル製膜装置、③三次元積層デバイスの実装評価技術、④高速・高精度・欠陥フリーエッチング装置、⑤高周波高分解能磁界プローブ、⑥MEMS と LSI の集積化のためのウェハ貼り合わせ・接合技術。

(6) 技術社会システムの研究

MEMS/LSI の研究拠点について、アメリカを中心とした海外拠点の調査、乗り合いウェハシステムの課題の抽出、および協働機関とともに必要なルール策定や仕組みの構築を行った。こうした研究調査の結果を拠点内へ展開した。

c. 平成 21 年度

計画； 基盤技術を、拠点や共通利用可能な技術として確立する。乗合ウェハシステムのルールや手続き、手順などを構築して、研究開発システムを軌道に乗せる。それらを活用して、実用化に向けた研究課題の検討を行う。社会人向け実践的育成プログラムを実施し、不足している本分野の研究者・開発者を育成する。連携企業との知的財産システムを充実させ軌道に乗せる。

・実績

(1) 次世代携帯機器の研究

マルチバンド集積化無線チップ用レゾネータ・スイッチについて性能向上の指針を見出した。乗合ウェハによる LSI 上への高周波 MEMS 試作完了し課題を把握した。オンチップ高周波スイッチング DC-DC コンバータ研究で、モデルインダクタを設計できた。LSI チップに形成したコブレナ線路のノイズ抑制効果が高いことを見出し定量的説明を明確化した。マイクロ SOFC 用成膜技術開発に成功し、単セル試作で 400℃での起電力発生を確認した。

(2) 無線センサ、超高感度・高機能センサの研究

表面弾性波センサ用材料の薄膜化を行い、加速度や

力センサなどへの応用可能性を明らかにした。環境モニタリングセンサと LSI との一体化技術を考案し、可能性を明らかにした。過酷環境センサ用 SiC 堆積技術開発を行い、センサを試作し動作確認した。改良した回転体用無線センサを加工装置に取り付けて評価し、駆動回路やアンテナの設計指針を得た。

(3) 光マイクロシステムの研究

走査領域可変スキャナを開発し動作を確認した。走査角度拡大を目的に圧電薄膜作製技術開発を実施し有効性を確認した。焦点可変ミラーの開発を行い、スキャナと組み合わせて機能を確認した。微小光学部品用実装・集積技術開発を行い、低損失化を確認した。

(4) バイオ・医療マイクロシステムの研究

集積型マイクロバイオセンサシステムの機能を実証し酵素活性や抗原解析・細胞の遺伝子発現の電気化学的検出を可能とした。抗体固定機能集積バイオ流体 MEMS 研究で細胞収集システム試作ができた。医療用超音波・MRI デバイス用 LSI 設計・試作を行い動作確認を行った。カテーテルや内視鏡への実装も行う課題を見出した。

5) 製造・検査装置の研究

金属や樹脂を用いたウェハ接合技術を開発しデバイスへの適応可能性を実証した。パルス変調プラズマ/中性粒子ビーム装置を用いて超低損傷 Si エッチングを実証した。コンフォーマルコーティング装置でプラスチック用テフロンコーティング技術を確立した。三次元実装用非破壊非接触検査システム性能向上を実現した。三次元電磁界プローブによる評価で、LSI/MEMS の電磁ノイズ問題を明確化した。光制御並列電子源を開発し、リソグラフィ性能を評価した。

(6) 技術社会システムの研究

国内外の調査研究結果をもとに本拠点形成に向けてオープンコラボレーション、人材育成、拠点の世代交代などの方針と戦略についての提言を行った。報告書として3年間の取りまとめを実施した。

d. 平成 22 年度

・計画； 新たな研究課題に対応して、基盤技術を拡充しつつ、個々のマイクロシステムの研究開発を継続する。乗合ウェハで試作の LSI と MEMS の融合を図り、機能を実証し、乗合ウェハシステムの有効性を確認する。いくつかのマイクロシステムが、コンセプトの実証段階から試作品開発段階に移行する。また、新たなコンセプトのマイクロシステムや関連技術の研究開発を開始する。

e. 平成 23 年度

・計画； 研究開発を継続し、いくつかのマイクロシステムが、コンセプトの実証段階から試作品開発段階

に移行する。また、新たなコンセプトのマイクロシステムや関連技術の研究開発が進行する。

f. 平成 24 年度

・計画； いくつかのマイクロシステムが、試作品開発段階から実用化開発段階に移行する。開発したマイクロデバイスのシステムへの組み込みや実際の形での試用を進める。

g. 平成 25 年度

・計画； 最先端デザインルール of LSI とマイクロシステムとを一体化する基盤技術の新たな研究開発課題を解決し、拠点としての共用施設を整備して開かれた研究開発システムを構築する。また、分野ごとのマイクロシステム研究開発に幅広く適用できる LSI を開発する。そうすることで、様々な高度な機能を有し、複雑な情報処理を行う集積化マイクロシステムを実現するための基盤技術を確立する。これらの LSI との融合で、いくつかの集積化マイクロシステムの機能を確認し実用化の見通しを得る。世界的な拠点に相応しい開かれた研究開発システム、人材育成・教育システム、および知的財産システムを整え、これらを自立的に維持する基盤を整える。

h. 平成 26 年度

・計画； 実用化開発段階に移行したマイクロシステムの中から商品開発段階に移行するものを登場させる。

i. 平成 27 年度

・計画； 構築した研究開発システム、人材育成・教育システム、および知的財産システムを運用し、継続的に成果を生み出す。前年度の活動・成果を一層充実させる。

j. 平成 28 年度

・計画； 新規な知財取り扱いに基づく知財群および大学の知を触媒とした企業同士の研究開発を可能とする開かれた研究開発システムが確立され運用できる拠点が構築される。開発した融合化マイクロシステム技術が様々な分野で市場競争力を生み出す源泉となり、構築した開かれた研究開発システム、人材育成・教育システム、および知的財産システムを運用して新たなイノベーションの種を継続的に生み出す。また、専門的知識を有するとともに、拠点を理解するマイクロシステム分野のイノベーションを支える人材の継続的供給源となる。そして、本拠点の成果を、企業が事業として育てていくことができる拠点となっている。

9. 年次計画

項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
◎機関全体としての拠点化構想	革新的マイクロナノ集積化・加工技術の開発				
基盤技術の開発	←		集積化・加工の産業化技術の開発		
応用展開	←		乗合ウェハによる融合デバイス、センサシステムなどの開発		
人材育成	←		人材育成プログラムの整備		
システム改革	←		知的財産制度の整備		
			開かれた共用施設を中心とする開かれた研究開発システムの構築		
◎調整費充当計画	LSI とマイクロシステムの融合技術の研究 (革新的プロセス技術の研究)				
基盤技術の開発 (集積化技術)	←		LSI とマイクロシステムの融合技術の展開		
応用展開 (集積化技術応用)	←		LSI 集積化マイクロシステムの開発		
拠点設備の整備	←		基盤技術の展開による共用施設の整備		
産学連携モデルの構築	←		産学連携モデルの実践・検証		
総計	750 百万円	630 百万円	637 百万円		
うち調整費分	302 百万円	293 百万円	300 百万円		

項目	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
◎機関全体としての拠点化構想	革新的マイクロ・ナノ加工の産業化技術の開発				
基盤技術の開発	←		集積化マイクロ医療化ツール、集積化光システム、製造検査装置、高感度センサなどの開発		
応用展開	←		人材育成プログラムの推進・人材の供給		
人材育成	←		実用化・産業化		
システム改革	←		共用施設を中心とする開かれた研究開発システムの構築		
			開かれた研究開発システムの実践		
◎調整費充当計画	LSI とマイクロシステムの融合技術の展開				
基盤技術の開発 (集積化技術)	←		LSI 集積化マイクロシステムの開発		
応用展開 (集積化技術応用)	←		イノベーション実現のための実用化・産業化技術の開発		
拠点設備の整備	←		基盤技術の展開による共用施設の整備		
産学連携モデルの構築	←		産業化設備の整備		
			産学連携モデルの検証		
			開かれた産学・産産学共同研究開発・実用化開発体制確立		
総計					
うち調整費分					

10. 諮問委員会

委員	所属	備考
川合 知二	大阪大学 産業科学研究所 教授	
岩井 洋	東京工業大学 フロンティア創造協同研究センター 教授	
井深 丹	タマティエルオー (株) 社長	
桑原 洋	日立マクセル (株) 会長	
堀池 靖浩	独立行政法人物質材料研究機構 名誉フェロー	